

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-008

上海硅产业集团股份有限公司

2024 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	338,761.17	319,030.13	6.18
营业利润	-116,307.57	17,867.77	-750.94
利润总额	-116,433.85	17,765.21	-755.40
归属于母公司所有者的净利润	-97,053.71	18,654.28	-620.28
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-124,306.16	-16,594.39	不适用
基本每股收益(元)	-0.353	0.068	-619.12
加权平均净资产收益率	-7.07	1.27	减少 8.34 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,926,984.24	2,903,175.58	0.82
归属于母公司的所有者权益	1,228,553.10	1,511,434.05	-18.72
股本	274,717.72	274,717.72	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.47	5.52	-19.02

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况说明

报告期内，全球半导体市场迎来复苏，根据 WSTS 统计，2024 年全球半导体市场规模为 6,276 亿美元，与上年同期相比增长 19%。但市场复苏从下游向上游传导尚需一定周期，同时受到全球半导体行业高库存水平影响，半导体硅片市场的复苏不及预期，根据 SEMI 统计，报告期内，全球半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅下跌 2.5%，其中：全球 300mm 半导体硅片出货面积与上年同期相比小幅微涨 2%，全球 200mm 半导体硅片出货面积与上年同期相比继续下跌 13%，而全球 100mm-150mm 半导体硅片出货面积与上年同期相比跌幅高达 20%。公司报告期内 300mm 半导体硅片的销量较上年同期大幅增加超过 70%，200mm 及以下尺寸半导体硅片（含 SOI 硅片）的销量（未折合成同一尺寸，数量统计包含受托加工服务）较上年同期小幅下降，不超过 10%，均优于同期市场整体表现。

根据 SEMI 预测，报告期内全球半导体硅片（含 SOI 硅片）市场规模预计为 143 亿美元，与上年同期相比下跌约 4%，而公司报告期内营业收入较上年同期仍实现小幅增长 6.18%，其中 300mm 半导体硅片的销售收入较上年同期增幅超过 50%。受产品平均单价下降的影响，报告期内营业利润及相关财务指标同比下滑。

（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30% 以上的主要原因说明：

公司报告期内受半导体硅片市场的复苏不及预期、以及部分客户仍处于去库存阶段和产品需求变化等的影响，200mm 及以下尺寸半导体硅片的销量与平均单价均下降，导致业绩表现下滑幅度较大，经初步商誉减值测试测算，相关资产组需计提的商誉减值损失合计约为 3 亿元，占报告期内公司归属于母公司所有者的净利润的比例超过 30%。

此外，公司报告期内公司扩产项目纷纷取得重要进展，其中于上海临港新片区实施的新增 30 万片/月的 300mm 半导体硅片产能建设项目全面投产，于山西

太原实施的集成电路用 300mm 硅片产能升级项目在报告期末也已顺利通线，建设完成 5 万片/月产能规模的中试线，报告期末，公司 300mm 半导体硅片产能规模已达到 65 万片/月。但半导体硅片扩产项目存在前期投入大、固定成本高的特点，因此对公司报告期内的业绩表现有较大影响，仅前述两扩产项目在报告期内对利润总额的影响约-2 亿元。

同时，公司始终保持较高水平的研发投入，研发投入占营业收入的比例逐年增加，虽对公司短期业绩表现有一定影响，但随着新产品投入生产并实现销售，将有效提升公司的市场竞争力和盈利能力，并有利于公司长期业绩表现。

综合上述影响，公司报告期内的营业利润较上年同期下降 750.94%，利润总额较上年同期下降 755.40%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 620.28%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损增加 107,711.77 万元，基本每股收益较上年同期下降 619.12%，加权平均净资产收益率减少 8.34 个百分点。

三、风险提示

本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2024 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2024 年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、与会计师事务所沟通情况

本次业绩快报的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩快报已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩快报方面不存在分歧。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日